SN74LVC1G04-Q1 单通道反相器门

1 特性

- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性：
  - 器件温度等级 1：
    - –40°C 至 125°C 环境工作温度范围
  - 器件 HBM ESD 分类等级 H2
  - 器件 CDM ESG 分类等级 C4B
- ESD 保护超过 2000V（根据 MIL-STD-883 方法 3015）；超过 200V（使用机器模型，C = 200pF，R = 0）
- 支持 5V V_{CC} 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 3.3V 时 t_{pd} 最大值为 3.3ns
- 低功耗，I_{CC} 最大值为 10 µA
- 3.3V 时，输出驱动为 ±24mA
- I_{off} 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD 78 II 类规范的要求

2 应用

- 车身控制模块
- 引擎控制模块
- 信息娱乐系统
- 远程信息处理

3 说明

该单路反相门设计在 1.65V 至 5.5V V_{CC} 下运行。

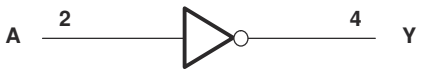
SN74LVC1G04-Q1 执行布尔函数 $Y = \overline{A}$。

该器件专用于使用 I_{off} 的局部断电应用。I_{off} 电路可禁用输出，以防在器件掉电时电流回流损坏器件。

器件信息

器件型号	封装(1)	封装尺寸(2)	本体尺寸（标称值）(3)
SN74LVC1G04-Q1	DBV（SOT-23，5）	2.90mm × 2.80mm	2.90mm × 1.60mm
	DCK（SC-70，5）	2.00mm × 2.10mm	2.00mm × 1.25mm
SN74LVC1G04I-Q1	DCK（SC-70，5）	2.00mm × 2.10mm	2.00mm × 1.25mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。
(3) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，不包括引脚。



逻辑图（正逻辑）

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见，TI 提供了译文；由于翻译过程中可能使用了自动化工具，TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性，请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本（控制文档）。

内容

1 特性.....1
2 应用.....1
3 说明.....1
4 引脚配置和功能.....3
5 规格.....4
5.1 绝对最大额定值.....4
5.2 ESD 等级.....4
5.3 建议运行条件.....5
5.4 热性能信息.....5
5.5 电气特性.....6
5.6 开关特性.....6
5.7 开关特性.....6
5.8 工作特性.....6
5.9 典型特性.....7
6 参数测量信息.....8
7 详细说明.....10
7.1 概述.....10
7.2 功能方框图.....10
7.3 特性说明.....10
7.4 器件功能模式.....10
8 应用和实施.....11
8.1 应用信息.....11
8.2 典型应用.....11
8.3 电源相关建议.....12
8.4 布局.....12
9 器件和文档支持.....13
9.1 文档支持.....13
9.2 接收文档更新通知.....13
9.3 支持资源.....13
9.4 商标.....13
9.5 静电放电警告.....13
9.6 术语表.....13
10 修订历史记录.....13
11 机械、封装和可订购信息.....14

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

4 引脚配置和功能

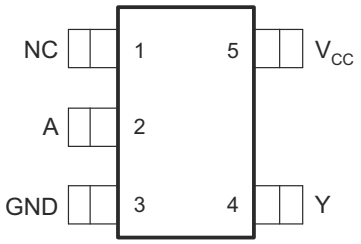
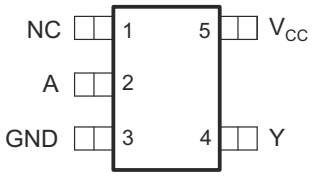


图 4-1. DBV 5 引脚 SOT-23 顶视图



NC — 无内部连接

有关封装尺寸，请参阅数据表末尾的机械图纸。

图 4-2. DCK 5 引脚 SC-70 顶视图

表 4-1. 引脚功能

引脚		I/O	说明
名称	编号		
A	2	I	逻辑输入
GND	3	—	接地
NC	1	—	无内部连接
V_{CC}	5	I	电源电压
Y	4	O	反相逻辑输出

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）(1)

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围		-0.5	6.5	V
V_I	输入电压范围(2)		-0.5	6.5	V
V_O	在高阻抗或断电状态对任一输出施加的电压范围(2)		-0.5	6.5	V
V_O	应用到任一处于高电平或低电平状态输出的电压范围(2) (3)		-0.5	V_{CC} + 0.5	V
I_{IK}	输入钳位电流	V_I < 0		-50	mA
I_{OK}	输出钳位电流	V_O < 0		-50	mA
I_O	持续输出电流			±50	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流			±100	mA
θ_{JA}	封装热阻(4)	DBV 封装		206	°C/W
		DCK 封装		252	
T_{stg}	贮存温度范围		-65	150	°C

(1) 应力超出*绝对最大额定值*下面列出的值时可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力等级，并不表示器件在这些条件下以及在*建议工作条件*以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则允许超出输入负压和输出电压额定值。
(3) V_{CC} 的值在建议运行条件表中提供。
(4) 封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。

5.2 ESD 等级

			值	单位
采用 DBV 封装的 SN74LVC1G04-Q1				
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1)	±2000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2)	±750	
采用 DCK 封装的 SN74LVC1G04-Q1				
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准(1)	±2000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2)	±750	

(1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 可通过标准 ESD 控制流程实现安全生产。
(2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）(1)

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	工作	1.65	5.5	V
		仅数据保留	1.5		
V_{IH}	高电平输入电压	V_{CC} = 1.65V 至 1.95V	0.65 × V_{CC}		V
		V_{CC} = 2.3V 至 2.7V	1.7		
		V_{CC} = 3V 至 3.6V	2		
		V_{CC} = 4.5V 至 5.5V	0.7 × V_{CC}		
V_{IL}	低电平输入电压	V_{CC} = 1.65V 至 1.95V		0.35 × V_{CC}	V
		V_{CC} = 2.3V 至 2.7V		0.7	
		V_{CC} = 3V 至 3.6V		0.8	
		V_{CC} = 4.5V 至 5.5V		0.3 × V_{CC}	
V_I	输入电压		0	5.5	V
V_O	输出电压		0	V_{CC}	V
I_{OH}	高电平输出电流	V_{CC} = 1.65V		-4	mA
		V_{CC} = 2.3V		-8	
		V_{CC} = 3V		-16	
				-24	
		V_{CC} = 4.5V		-32	
I_{OL}	低电平输出电流	V_{CC} = 1.65V		4	mA
		V_{CC} = 2.3V		8	
		V_{CC} = 3V		16	
				24	
		V_{CC} = 4.5V		32	
$\Delta t/\Delta v$	输入转换上升或下降速率	V_{CC} = 1.8V ± 0.15V，2.5V ± 0.2V		20	ns/V
		V_{CC} = 3.3V ± 0.3V		10	
		V_{CC} = 5V ± 0.5V		5	
T_A	自然通风条件下的工作温度范围	“Q”后缀器件	-40	125	°C
		“I”后缀器件	-40	85	

(1) 器件的所有未使用输入必须保持在 V_{CC} 或 GND，以确保器件正常运行。请参阅 TI 应用报告 *CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响*，文献编号 SCBA004。

5.4 热性能信息

热指标(1)		SN74LVC1G04-Q1		单位
		DBV (SOT-23)	DCK (SC-70)	
		5 引脚	5 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	357.1	371.0	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	263.7	297.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	264.4	258.6	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	195.6	195.6	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	262.2	256.2	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	–	–	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅*半导体和 IC 封装热指标*应用手册。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5.5 电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数		测试条件	V_{CC}	最小值	典型值 (1)	最大值	单位
V_{OH}		I_{OH} = -100 μA	1.65V 至 5.5V	V_{CC} – 0.1			V
		I_{OH} = -4mA	1.65V	1.2			
		I_{OH} = -8mA	2.3V	1.9			
		I_{OH} = -16mA	3V	2.4			
		I_{OH} = -24mA		2.3			
		I_{OH} = -32mA	4.5V	3.8			
V_{OL}		I_{OL}=100 μA	1.65V 至 5.5V			0.1	V
		I_{OL} = 4mA	1.65V			0.45	
		I_{OL} = 8mA	2.3V			0.3	
		I_{OL} = 16mA	3V			0.4	
		I_{OL} = 24mA				0.55	
		I_{OL} = 32mA	4.5V			0.55	
I_I	A 输入	V_I = 5.5V 或 GND	0 至 5.5V			±5	μA
I_{off}		V_I 或 V_O = 5.5V	0			±10	μA
I_{CC}		V_I = 5.5V 或 GND， I_O = 0	1.65V 至 5.5V			10	μA
ΔI_{CC}		一个输入电压为 V_{CC} – 0.6 V， 其他输入电压为 V_{CC} 或 GND	3V 至 5.5V			500	μA
C_i		V_I = V_{CC} 或 GND	3.3V		3.5		pF

(1) 所有典型值均在 V_{CC} = 3.3V、T_A = 25°C 下测得。

5.6 开关特性

在自然通风条件下的建议工作温度范围内，C_L = 15pF（除非另有说明）（请参阅图 6-1）

参数	从（输入）	至（输出）	V_{CC} = 1.8V ± 0.15V		V_{CC} = 2.5V ± 0.2V		V_{CC} = 3.3V ± 0.3V		V_{CC} = 5V ± 0.5V		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{pd}	A	Y	2	6.4	1	4.2	0.7	3.3	0.7	3.1	ns

5.7 开关特性

在建议的自然通风工作温度范围内，C_L = 30pF 或 50pF（除非另有说明）（请参阅 图 7-1）

参数	从（输入）	至（输出）	V_{CC} = 1.8V ± 0.15V		V_{CC} = 2.5V ± 0.2V		V_{CC} = 3.3V ± 0.3V		V_{CC} = 5V ± 0.5V		单位
			最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t_{pd}	A	Y	3	7.5	1.4	5.2	1	4.2	1	3.7	ns

5.8 工作特性

T_A = 25°C

参数		测试条件	V_{CC} = 1.8V	V_{CC} = 2.5V	V_{CC} = 3.3V	V_{CC} = 5V	单位
			典型值	典型值	典型值	典型值	
C_{pd}	功率耗散电容	f = 10MHz	16	18	18	20	pF

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

5.9 典型特性

T_A = 25°C

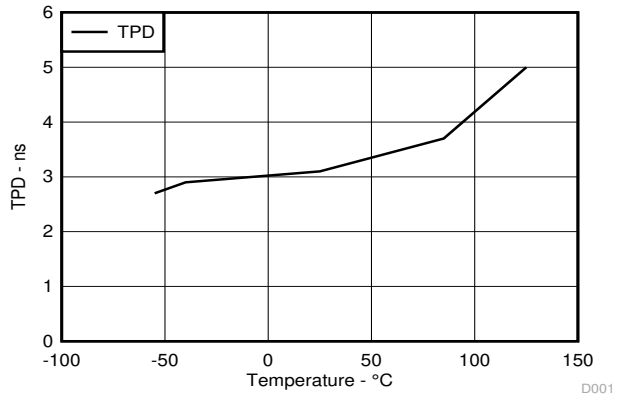


图 5-1. 3.3V V_{CC} 时 TPD 与温度间的关系

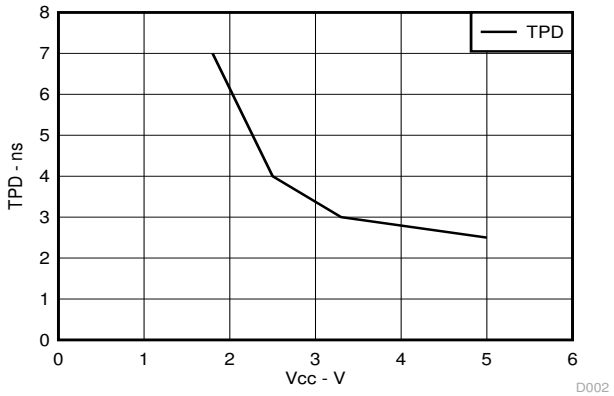
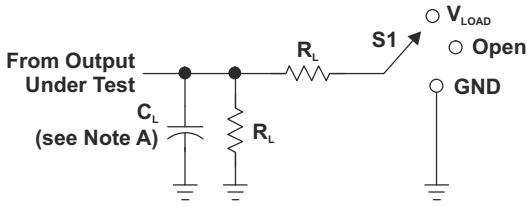


图 5-2. 25°C 时 TPD 与 V_{CC} 间的关系

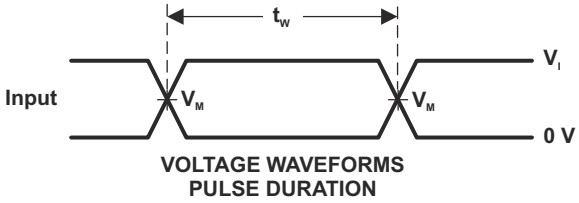
6 参数测量信息



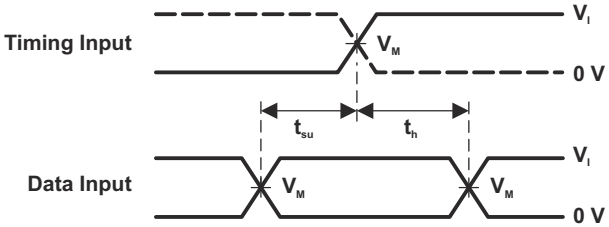
LOAD CIRCUIT

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

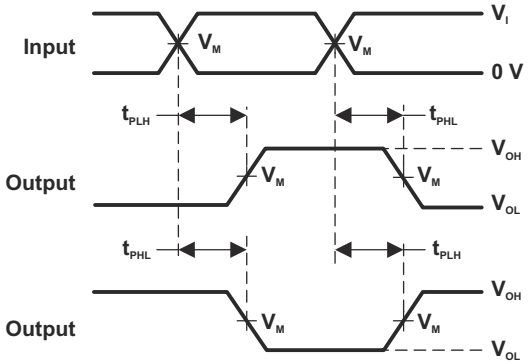
V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_Δ
	V_I	t_r/t_f					
1.8 V ± 0.15 V	V_{CC}	≤2 ns	$V_{CC}/2$	2 × V_{CC}	15 pF	1 MΩ	0.15 V
2.5 V ± 0.2 V	V_{CC}	≤2 ns	$V_{CC}/2$	2 × V_{CC}	15 pF	1 MΩ	0.15 V
3.3 V ± 0.3 V	3 V	≤2.5 ns	1.5 V	6 V	15 pF	1 MΩ	0.3 V
5 V ± 0.5 V	V_{CC}	≤2.5 ns	$V_{CC}/2$	2 × V_{CC}	15 pF	1 MΩ	0.3 V



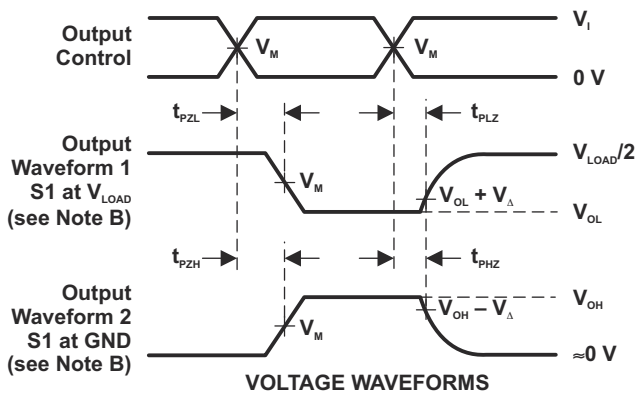
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION



VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS

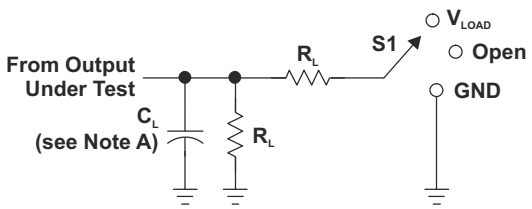


VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 10 MHz, Z_O = 50 Ω.
D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
E. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis}.
F. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en}.
G. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd}.
H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 6-1. 负载电路与电压波形、C_L = 15pF

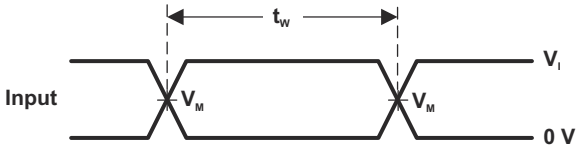
Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated



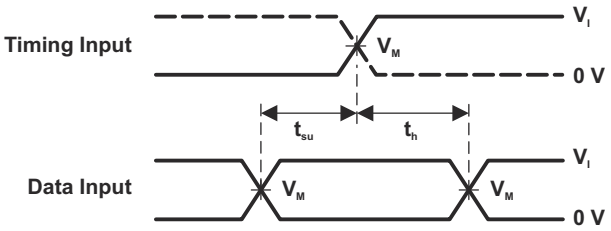
LOAD CIRCUIT

TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

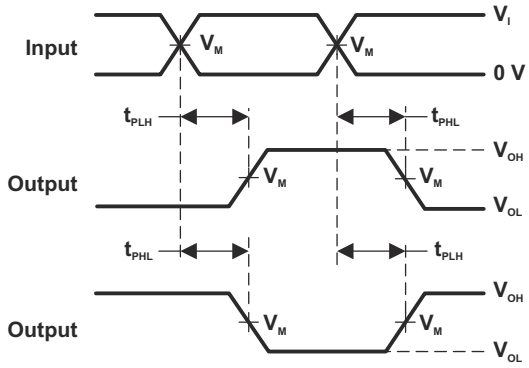
V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_Δ
	V_I	t_r/t_f					
1.8 V ± 0.15 V	V_{CC}	≤2 ns	$V_{CC}/2$	2 × V_{CC}	30 pF	1 kΩ	0.15 V
2.5 V ± 0.2 V	V_{CC}	≤2 ns	$V_{CC}/2$	2 × V_{CC}	30 pF	500 Ω	0.15 V
3.3 V ± 0.3 V	3 V	≤2.5 ns	1.5 V	6 V	50 pF	500 Ω	0.3 V
5 V ± 0.5 V	V_{CC}	≤2.5 ns	$V_{CC}/2$	2 × V_{CC}	50 pF	500 Ω	0.3 V



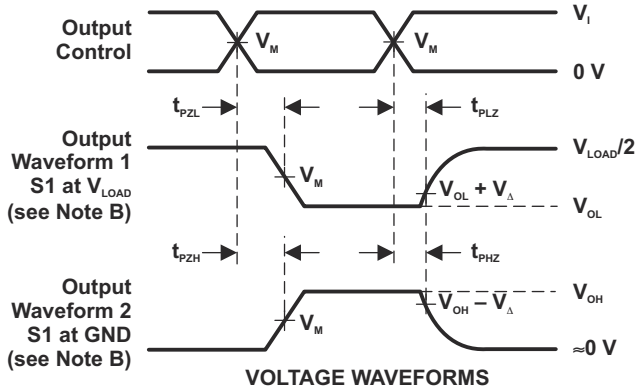
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION



VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES



VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTS



VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

NOTES: A. C_L includes probe and jig capacitance.
B. Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
C. All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR ≤ 10 MHz, Z_O = 50 Ω.
D. The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
E. t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis}.
F. t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en}.
G. t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd}.
H. All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 7-1. 负载电路与电压波形、C_L = 30pF

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

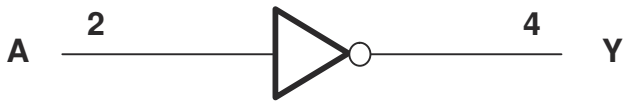
7 详细说明

7.1 概述

SN74LVC1G04-Q1 器件包含反相门并执行布尔函数 $Y = \overline{A}$。该器件完全适用于使用 I_{off} 的局部关断应用。I_{off} 电路可禁用输出，以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。

DPW 封装技术是 IC 封装中的一项重大突破。其小巧的 0.64mm2 的封装尺寸较之其他封装选项可显著节省布板空间，同时仍保留方便制造的 0.5mm 传统引线间距。

7.2 功能方框图



7.3 特性说明

- 宽工作电压范围。
  - 可在 1.65V 至 5.5V 范围内工作。
- 支持降压转换。
- 输入电压高达 5.5V。
- I_{off} 特性允许在 V_{CC} 为 0V 时在输入和输出上产生电压。

7.4 器件功能模式

功能表

输入 A	输出 Y
H	L
L	H

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

8 应用和实施

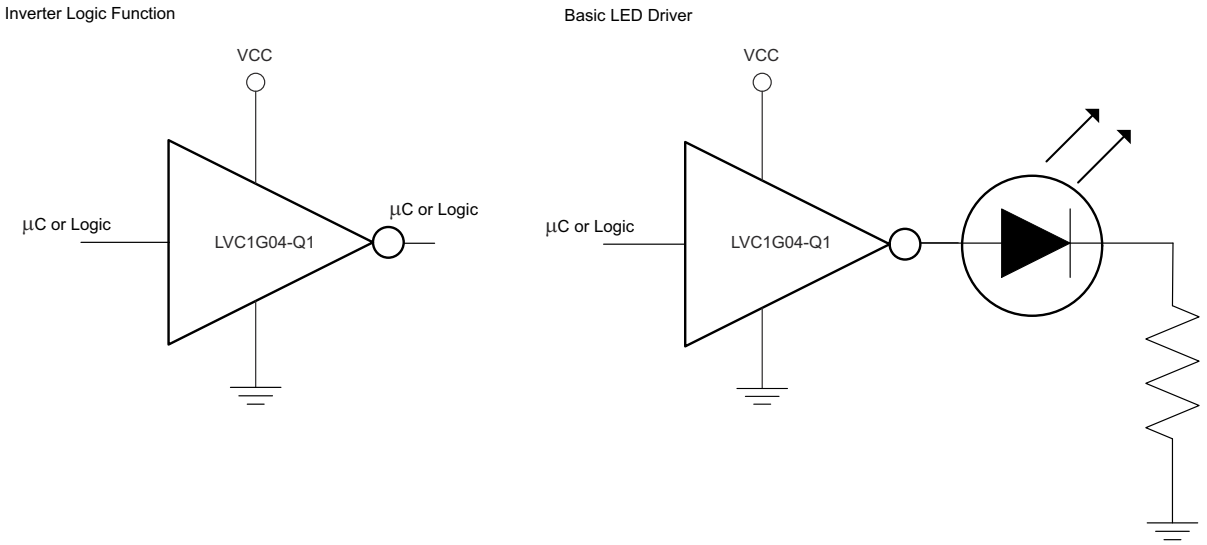
备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客 户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

8.1 应用信息

SN74LVC1G04-Q1 是一款高驱动 CMOS 器件，可用于实现具有高输出驱动的反转逻辑，例如 LED 应用。该器件可以在 3.3V 下产生 24mA 驱动电流，因此非常适合驱动多个输出，也适合用于高达 100Mhz 的高速应用。输入可耐受 5.5V 电压，允许将其降压转换至 V_{CC}。

8.2 典型应用



8.2.1 设计要求

此器件采用 CMOS 技术并具有平衡输出驱动。注意避免总线争用，因为它可以驱动超过最大限制的电流。高驱动也会在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。

8.2.2 详细设计过程

1. 建议的输入条件
   - 上升时间和下降时间规格：请参阅*建议运行条件* 表中的 $\Delta t/\Delta V$。
   - 指定的高电平和低电平：请参阅*建议运行条件* 表中的 V_{IH} 和 V_{IL}。
   - 输入可耐受过压，允许它们在任何有效 V_{CC} 下高达 *建议运行条件* 表中的（V_I 最大值）。
2. 建议的输出条件
   - 每路输出的负载电流不应超过（I_O 最大值）以及该器件的总电流（通过 V_{CC} 或 GND 的持续电流）。这些限值位于*绝对最大额定值* 表中。
   - 输出不应被拉至高于 V_{CC}。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

8.2.3 应用曲线

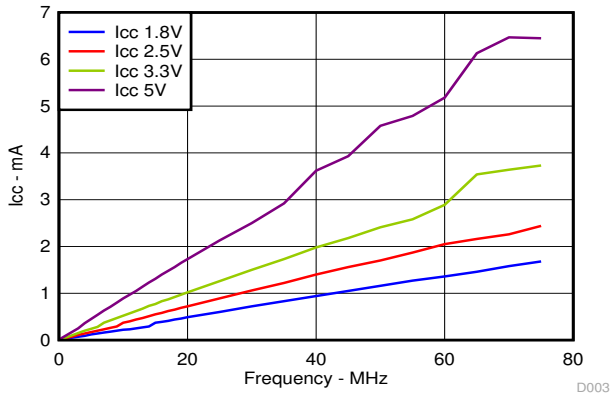


图 8-1. I_{CC} 与频率间的关系

8.3 电源相关建议

电源可以是*建议运行条件*中提供的最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。

每个 V_{CC} 引脚应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。对于单电源器件，建议使用 0.1 µF 电容器；如果有多个 V_{CC} 引脚，则建议为每个电源引脚使用 0.01µF 或 0.022µF 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1 µF 和 1 µF 电容器通常并联使用。为了获得更佳效果，旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。

8.4 布局

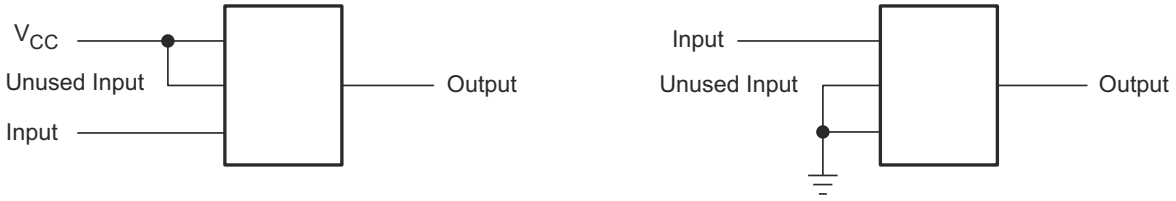
8.4.1 布局指南

当使用多位逻辑器件时，输入不应悬空。

在许多情况下，未使用数字逻辑器件的全部或部分功能；例如，仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个。此类输入引脚不应悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的运行状态。下一段指定在所有情况下都必须遵守的规则。

数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接至高或低偏置以防悬空。应根据器件的功能为任何特定未使用的输入施加逻辑电平。通常，将这些输入连接到 GND 或 VCC，具体情况视合理性或便利性而定。

8.4.2 布局示例



Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

9 器件和文档支持

9.1 文档支持

相关文档

有关相关文档，请参阅以下内容：

- 德州仪器 (TI)，*SN74LVC1G04-Q1 功能安全 FIT 率与故障模式分布*功能安全信息

9.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。点击*通知* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的使用条款。

9.4 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
所有商标均为其各自所有者的财产。

9.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.6 术语表

TI 术语表　　本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision E (June 2025) to Revision F (October 2025)	Page
• 将 DCK 封装的结至环境热阻值从：278°C/W 更改为：371.0°C/W	5
• 将 DCK 封装的结至外壳（顶部）热阻值从：93°C/W 更改为：297.5°C/W	5
• 将 DCK 封装的结至电路板热阻值从：65°C/W 更改为：258.6°C/W	5
• 将 DCK 封装的结至顶部特征值从：2°C/W 更改为：195.6°C/W	5
• 将 DCK 封装的结至电路板特征值从：64°C/W 更改为：256.2°C/W	5

Changes from Revision D (January 2013) to Revision E (June 2025)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式	1
• 删除了首页中的订购信息。请参阅数据表末尾的可订购产品附录	1
• 在器件信息表中添加了封装尺寸	1
• 添加了“ESD 等级”表	4
• 新增了“热性能信息”表	5
• 将 DBV 封装的结至环境热阻值从：206°C/W 更改为：357.1°C/W	5

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

- 将 DCK 封装的结至环境热阻值从：252°C/W 更改为：278°C/W 5
- 添加了“应用和实施”一节。 11
- 添加了“电源相关建议”部分。 12
- 添加了“布局”部分 12

Changes from Revision C (April 2008) to Revision D (January 2013)	Page
• 在“特性”部分添加了新列表项，第二项包含子列表	1

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

Copyright © 2025 Texas Instruments Incorporated

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package | Pins	Package qty | Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVC1G04QDBVRQ1	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(34Z5, 3NRH, 3VGF, C04O)
SN74LVC1G04QDBVRQ1.A	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(34Z5, 3NRH, 3VGF, C04O)
SN74LVC1G04QDBVRQ1.B	Active	Production	SOT-23 (DBV) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(34Z5, 3NRH, 3VGF, C04O)
SN74LVC1G04QDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	NIPDAU | SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(CCJ, CCO)
SN74LVC1G04QDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(CCJ, CCO)
SN74LVC1G04QDCKRQ1.B	Active	Production	SC70 (DCK) | 5	3000 | LARGE T&R	Yes	SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	(CCJ, CCO)

(1) **Status:** For more details on status, see our product life cycle.

(2) **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

(3) **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the TI RoHS Statement for additional information and value definition.

(4) **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

(5) **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

(6) **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC1G04-Q1 :

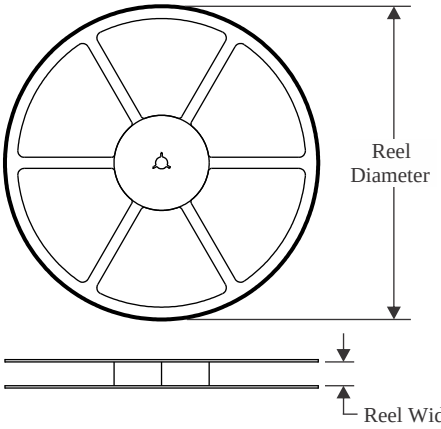
- Catalog : SN74LVC1G04
- Enhanced Product : SN74LVC1G04-EP

NOTE: Qualified Version Definitions:

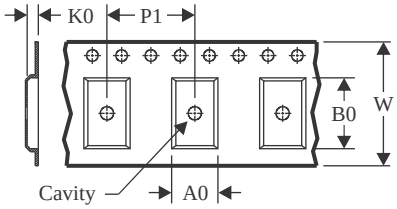
- Catalog - TI's standard catalog product
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

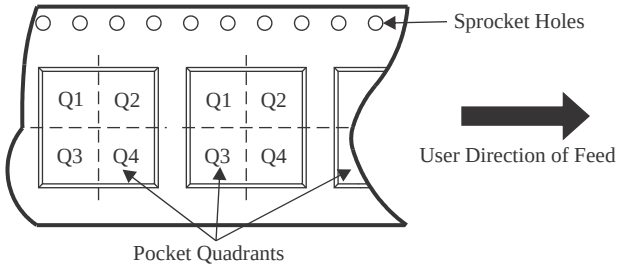


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

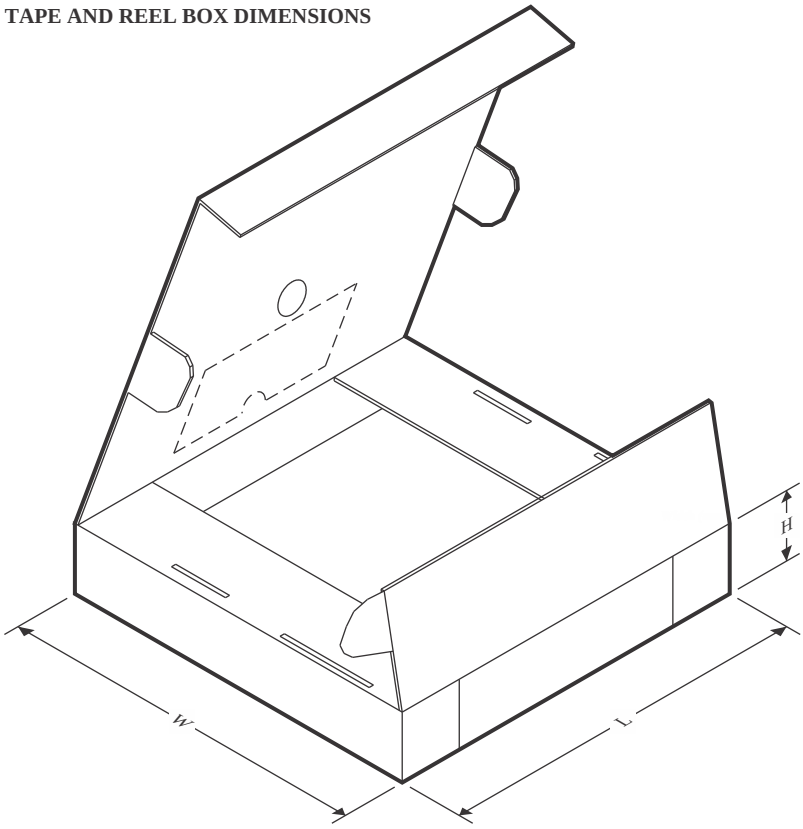
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	179.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	8.4	3.2	3.2	1.4	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G04QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G04QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	179.0	8.4	2.2	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

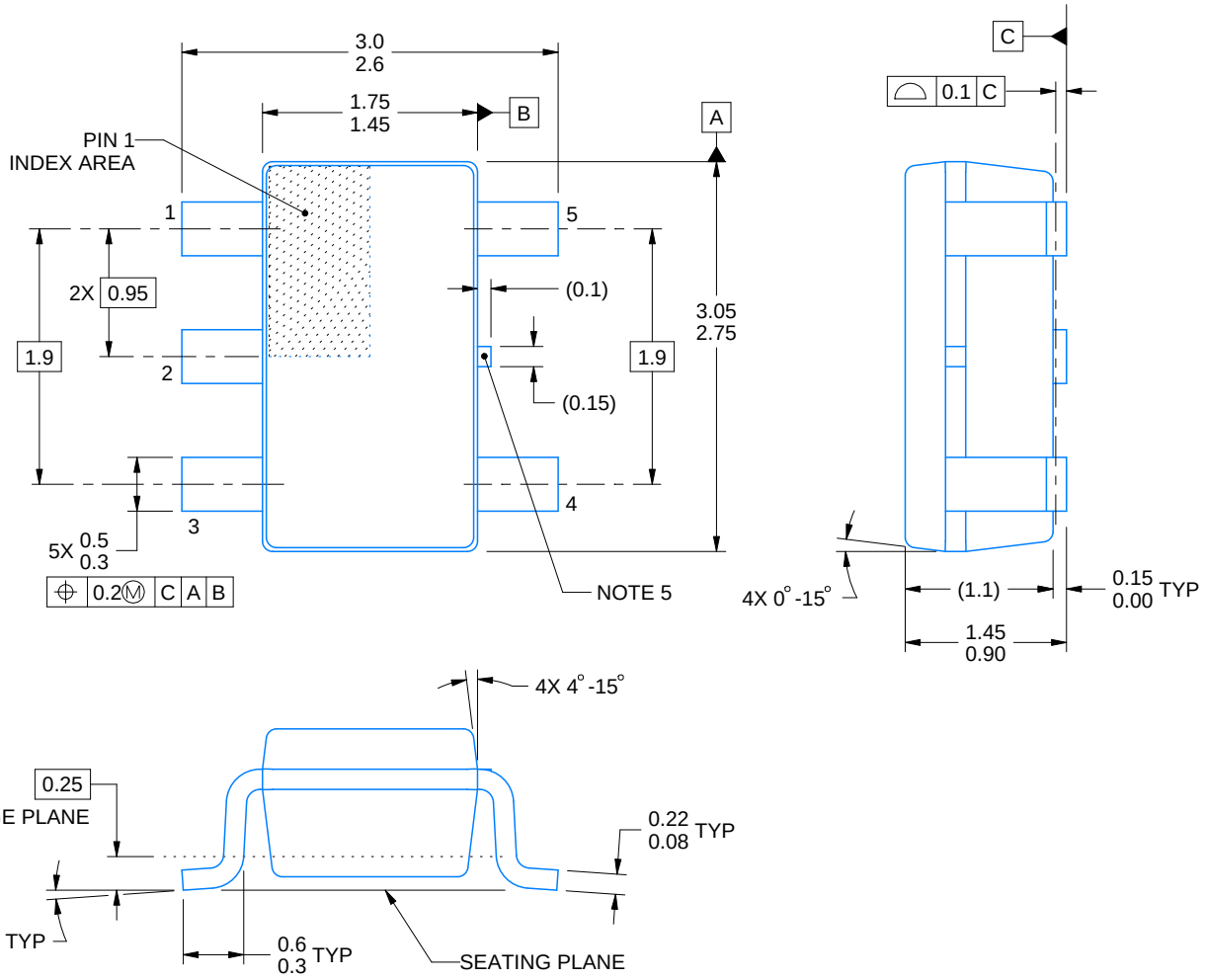
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	200.0	183.0	25.0
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LVC1G04QDBVRQ1	SOT-23	DBV	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LVC1G04QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	190.0	190.0	30.0
SN74LVC1G04QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	200.0	183.0	25.0

PACKAGE OUTLINE

DBV0005A

SOT-23 - 1.45 mm max height

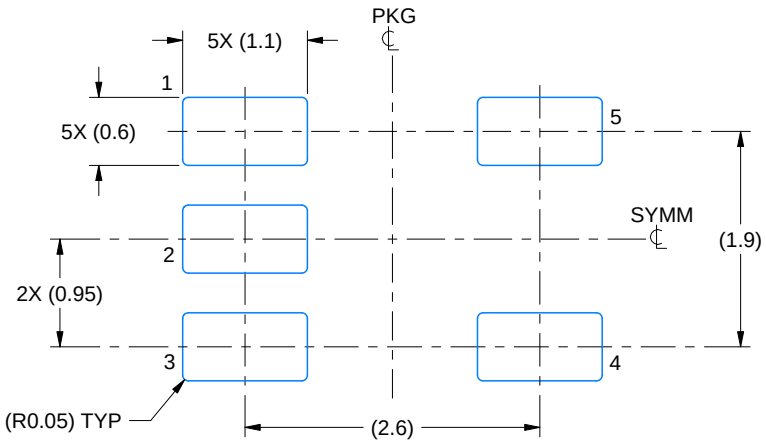
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



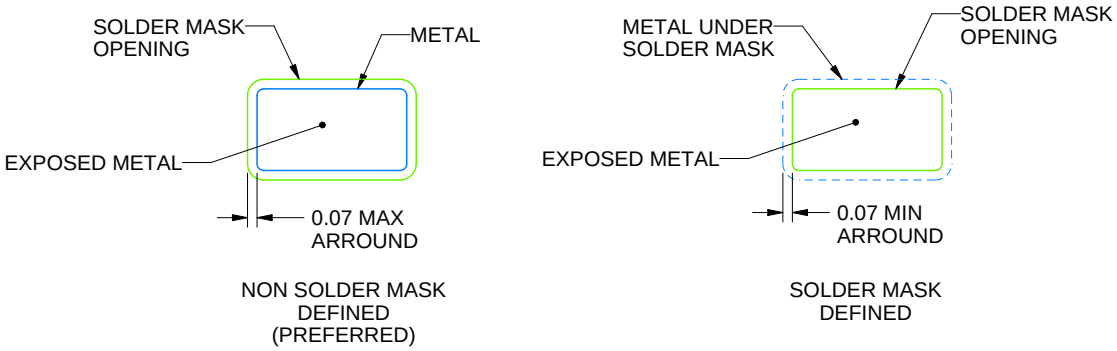
4214839/K 08/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:15X

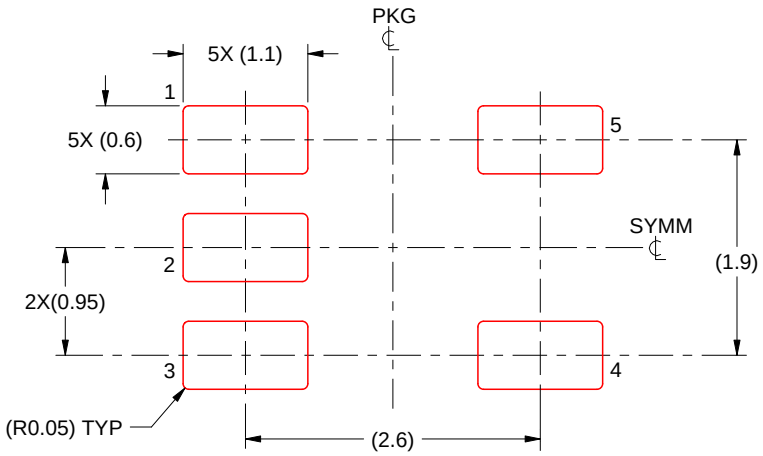


SOLDER MASK DETAILS

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE:15X

4214839/K 08/2024

NOTES: (continued)

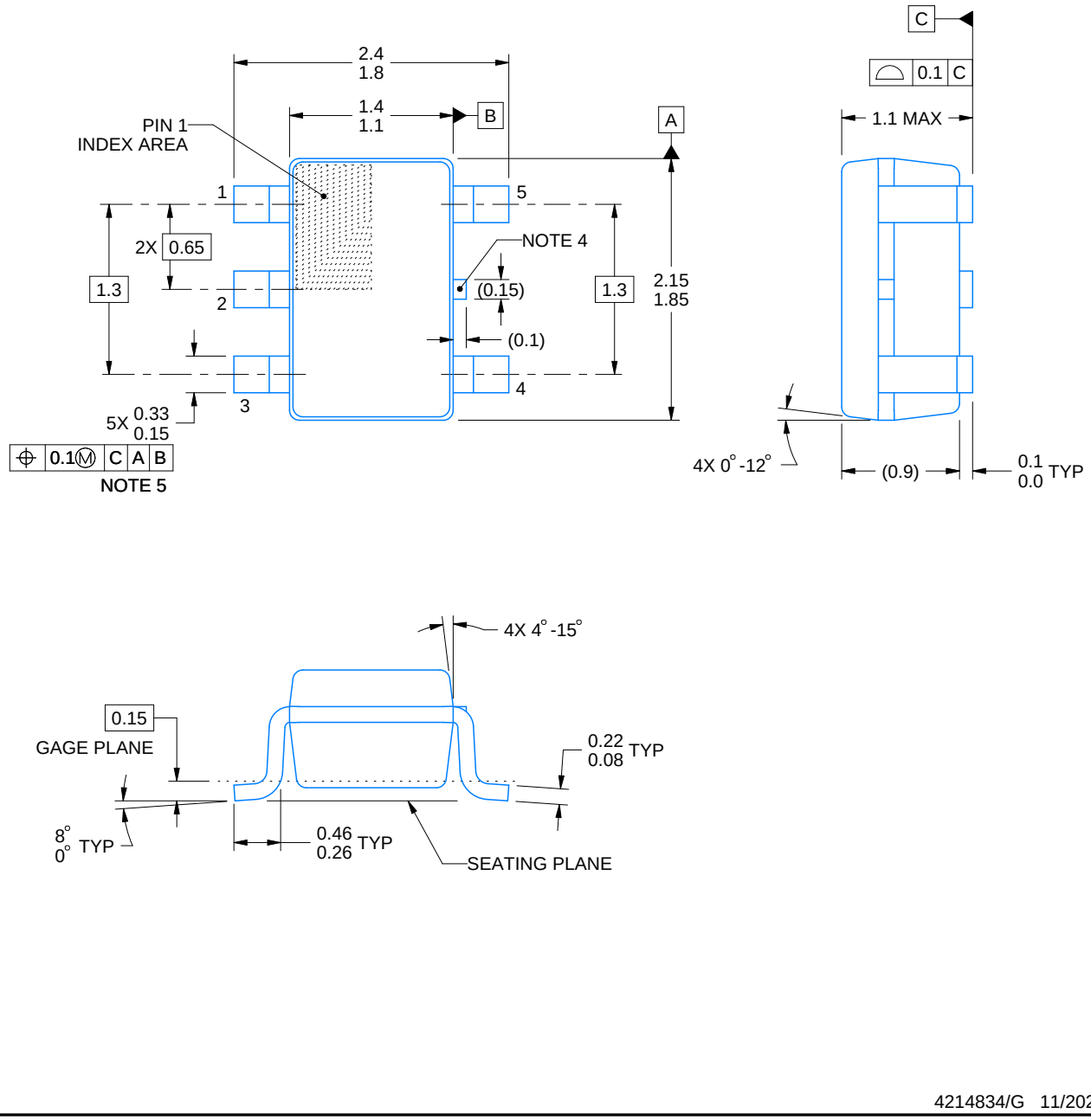
8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

PACKAGE OUTLINE

DCK0005A

SOT - 1.1 max height

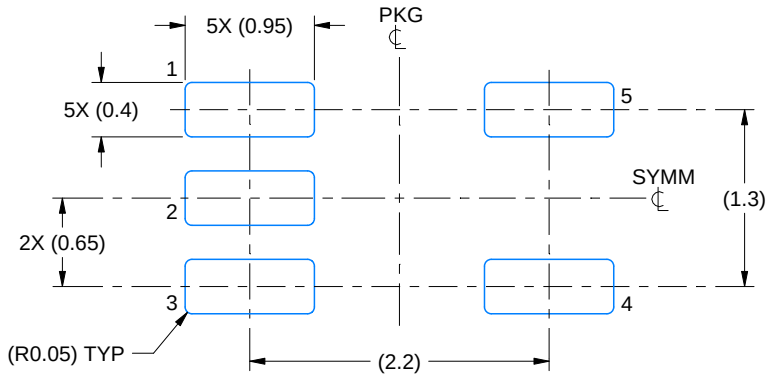
SMALL OUTLINE TRANSISTOR



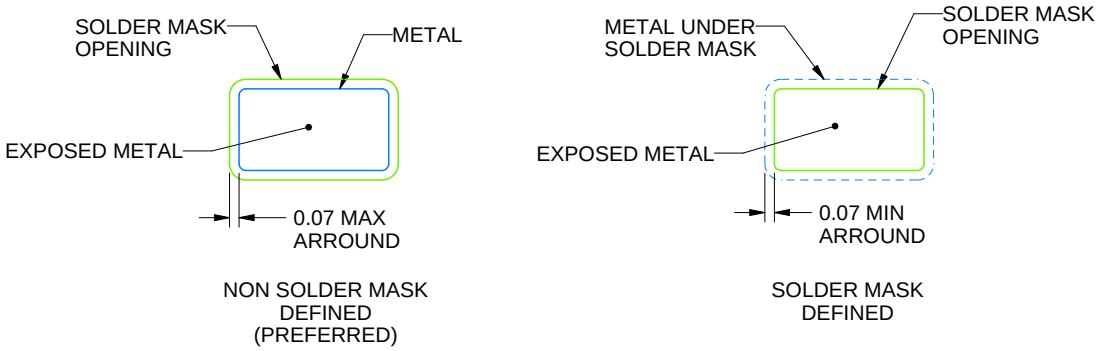
4214834/G 11/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

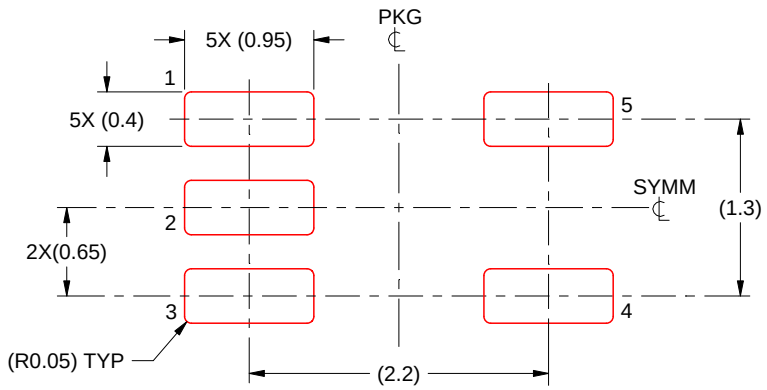


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 TI 销售条款)、TI 通用质量指南 或 ti.com 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。 除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月